

TI 在猶他州Lehi的下一個12吋半導體晶圓廠



110
億美元投資

猶他州史上
最大 經濟投資

約 800
個新 TI 工作機會及
上千個間接工作

2023
年末開始建造

2026
年即可投入生產

數以千萬計 的
每日將可製造
類比與嵌入式處理晶片

設計符合 LEED 金級認證

回收水率為現有
晶圓廠將近 2 倍

將於 Alpine School 區投資 9 萬美元



我們將在猶他州Lehi
創造半導體製造業的新紀元

欲知詳情,請造訪 TI.com/Lehi